

2005.11.29

印押

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

代理人  
河宮 治

様

PCT

あて名  
〒540-0001  
日本国大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号I  
MPビル 青山特許事務所特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）の  
送付の通知書(法施行規則第57条)  
〔PCT規則71.1〕発送日  
(日.月.年) 22.11.2005出願人又は代理人  
の書類記号 663906

重要な通知

国際出願番号  
PCT/JP2004/005772国際出願日  
(日.月.年) 22.04.2004優先日  
(日.月.年) 06.08.2003出願人（氏名又は名称）  
日本科学冶金株式会社

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告（付属書類を除く）の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

## 4. 注意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から3ヶ月以内に（官庁によってはもっと遅く）所定の手続（翻訳文の提出及び国内手数料の支払い）をしなければならない（PCT第39条（1））（様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照）。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、特許性に関する国際予備報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第II巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる（PCT第27条(5)も併せて参照）。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性又は裏付け要件を、特許要件から免除することも含む。

名称及びあて名 日本国特許庁（IPEA/JP） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
---

権限のある職員

特許庁長官

電話番号 03-3581-1101 内線 3565

5R 8835

## 注 意

### 1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であつて国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することができますが、独立行政法人工業所有権情報・研修館（特許庁庁舎2階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

#### [担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号（特許庁庁舎2階）

独立行政法人工業所有権情報・研修館

【公 報 類】 閲覧部 T E L 03-3581-1101 内線3811～2

【公報以外】 資料部 T E L 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

#### [申込方法]

(1) 特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

#### [申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

T E L 03-3508-2313

注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

### 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）

請 求 の 範 囲

1. 軟磁性成形体の製造に用いる複合粉末であつて、軟磁性体粉末の表面が少なくとも無機絶縁性材料を含む電気絶縁性材料で被覆され、該無機絶縁性材料の表面には軟磁性体粉末の表面を部分的に覆うように樹脂材料が融着されて成る軟磁性複合粉末。  
5
2. 上記軟磁性体粉末の表面が上記無機絶縁性材料から成る無機絶縁層で被覆され、該無機絶縁層に上記樹脂材料が融着されて成る請求項1記載の軟磁性複合粉末。
3. 上記電気絶縁性材料が上記樹脂材料を含む請求項1記載の軟磁性複合粉末。  
10
4. 上記無機絶縁性材料がガラス材料である請求項1から3のいずれか一つに記載の軟磁性複合粉末。
5. 上記軟磁性体粉末が非晶質軟磁性合金である請求項1から4のいずれか一つに記載の軟磁性複合粉末。  
15
6. 上記樹脂材料により造粒されて成る請求項1から5のいずれか一つに記載の軟磁性複合粉末。
7. 上記樹脂材料の粒径が軟磁性体粉末の粒径の半分以下である請求項2記載の軟磁性複合粉末。  
20
8. (補正後) 上記無機絶縁材料が0.3～6重量%、上記樹脂材料が3～8重量%、そして残部が上記軟磁性体粉末から成る請求項2記載の軟磁性体粉末。  
25
9. (補正後) 上記無機絶縁性材料がガラス材料であつて、該ガラス材料及び上記樹脂材料の粒径が軟磁性体粉末の粒径の半分以下であり、かつガラス材料0.3～10重量%、樹脂材料3～8重量%、そして残部が軟磁性体粉末から成る請求項1記載の軟磁性複合粉末。
10. 軟磁性体粉末の表面が少なくとも無機絶縁性材料を含む電気絶縁性材料で被覆され、該無機絶縁性材料の表面には軟磁性体粉末の表面を部分的に覆うように樹脂材料が融着されて成る軟磁性複合粉末の製造方法であつて、  
上記軟磁性体粉末を上記無機絶縁性材料で被覆し、次いで上記軟磁性体粉末と上記樹脂材料とを混合し、上記無機絶縁性材料に上記樹脂材料を融着させる軟磁

性複合粉末の製造方法。

11. 上記無機絶縁性材料がガラス材料であり、上記軟磁性体粉末の表面に該ガラス材料を融着させてガラス層を形成し、次いで該ガラス層に樹脂材料を融着させる請求項10記載の製造方法。

5 12. 上記ガラス材料が低融点ガラスである請求項10又は11に記載の製造方法。

13. 上記樹脂材料の粒径が軟磁性体粉末の粒径の半分以下である請求項10記載の製造方法。

10 14. (補正後) 上記複合粉末が、上記無機絶縁材料0.3~6重量%、上記樹脂材料3~8重量%、そして残部が上記軟磁性体粉末からなる請求項10記載の製造方法。

15 15. 軟磁性体粉末の表面が少なくとも無機絶縁性材料を含む電気絶縁性材料で被覆され、該無機絶縁性材料の表面には軟磁性体粉末の表面を部分的に覆うように樹脂材料が融着されて成る軟磁性複合粉末の製造方法であって、

上記軟磁性体粉末と、上記無機絶縁性材料と、上記樹脂材料とを混合し、軟磁性体粉末の表面を無機絶縁性材料と樹脂材料で被覆する一方、上記無機絶縁性材料に上記樹脂材料を融着させる軟磁性複合粉末の製造方法。

20 16. (補正後) 上記無機絶縁性材料がガラス材料であって、該ガラス材料及び上記樹脂材料の粒径が軟磁性体粉末の粒径の半分以下であり、かつ上記複合粉末が、ガラス材料0.3~10重量%、樹脂材料3~8重量%、そして残部が軟磁性体粉末から成る請求項15記載の製造方法。

25 17. 軟磁性体粉末の表面が少なくとも無機絶縁性材料を含む電気絶縁性材料で被覆され、該無機絶縁性材料の表面には軟磁性体粉末の表面を部分的に覆うように樹脂材料が融着されて成る軟磁性複合粉末を金型内に充填し加圧して圧粉体となし、次いで該圧粉体を焼成して焼成体となす軟磁性成形体の製造方法。

18. 軟磁性体粉末の表面が少なくとも無機絶縁性材料を含む電気絶縁性材料で被覆され、該無機絶縁性材料の表面には軟磁性体粉末の表面を部分的に覆うように樹脂材料が融着されて成る軟磁性複合粉末に樹脂材料を添加し混練して射出成形体となす軟磁性成形体の製造方法。